

smthybridpackaging

Internationale Fachmesse und Kongress
für Systemintegration in der Mikroelektronik

International Exhibition and Conference
for System Integration in Micro Electronics

Nürnberg, 26. - 28.04.2016

Nuremberg, 26 - 28 April 2016

Forenprogramm
Forum Program



smthybridpackaging

Podiumsdiskussionen und Produktpräsentationen 2016 *Panel Discussions and Vendor Presentations 2016*

Messeforum, Halle 7A, Stand 7A-335 *Exhibition Forum, hall 7A, booth 7A-335*

Dienstag, 26.04.2016	<i>Tuesday, 26 April 2016</i>	Seite 3	<i>Page 3</i>
Mittwoch, 27.04.2016	<i>Wednesday, 27 April 2016</i>	Seite 4	<i>Page 4</i>
Donnerstag, 28.04.2016	<i>Thursday, 28 April 2016</i>	Seite 5	<i>Page 5</i>

EMS / PCB Forum, Halle 6, Stand 6-230 *EMS / PCB Forum, hall 6, booth 6-230*

Dienstag, 26.04.2016	<i>Tuesday, 26 April 2016</i>	Seite 6	<i>Page 6</i>
Mittwoch, 27.04.2016	<i>Wednesday, 27 April 2016</i>	Seite 7	<i>Page 7</i>

smthybridpackaging

Messeforum Halle 7A, Stand 7A-335

Exhibition Forum hall 7A, booth 7A-335

Dienstag, 26.04.2016 Tuesday, 26 April 2016

Uhrzeit Time	Firma Company	Referent Speaker	Thema Topic
Thema / Theme: „Optic Meets Electronics“			
10:00 - 10:15	TBA	TBA	TBA
10:15 - 10:30	TBA	TBA	TBA
10:30 - 10:45	TBA	TBA	TBA
10:45 - 11:00	TBA	TBA	TBA
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
11:00 - 12:00	Fraunhofer IZM	Ulf Oestermann	Leben und Arbeiten in der digitalisierten Gesellschaft
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
12:00 - 12:20	SmartRep GmbH	Hans Jürgen Sauter	Automatisiertes Materialmanagement - das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort
12:20 - 12:40	GÖPEL electronic GmbH	Jens Kokott	Multispektral - Multidimensional - Multimodular Die AOI-Systeme von GÖPEL electronic
12:40 - 13:00	Hesse GmbH	Sebastian Holtkämper	Copper wire bonding ready for industrial mass production
13:00 - 13:20	HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH	Annemarie Maletic	Dienstleistungsspektrum der HTV-Firmengruppe
13:20 - 13:40	Koh Young Europe GmbH	Harald Eppinger	Realtime SPC und Prozessoptimierung auf Basis von echten 3D Messwerten
13:40 - 14:00	Henkel AG & Co. KGaA	Richard Boyle	Temperature Stable Solder Paste
14:00 - 14:20	Nordson Deutschland GmbH Niederlassung Nordson EFD Deutschland Oberhaching	Peter Langer	Neue Technologien in der Mikrodosierung
14:20 - 14:40	GPS Technologies GmbH	Andreas Gerspach	High Mix / Low Volume - Fertigung als Eckpfeiler der Wachstumsstrategie
14:40 - 15:00	iTAC Software AG	Andreas Rudl	Wie optimiert MES & Industrie 4.0 die Elektronikfertigung?
15:00 - 15:20	Mentor Graphics (Deutschland) GmbH	Michael Ford	Open Manufacturing Language (OML)
15:20 - 15:40	Weller Tools GmbH	Ouadie Lakrimi	Neue Löt- und Heißluftstationen Generation bei Weller – anwenderfreundlich wie nie.
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
16:00 - 16:30	Robert Bosch GmbH F&K Delvotec Bondtechnik GmbH	Dr. Friedhelm Guenter Benjamin Mehlmann	Verbundprojekt FlexJoin – Prozesssichere System- und Fügetechnik zur flexiblen Produktion von Batteriemodulen u.a. unter Einsatz von kombinierter Laser- und Ultraschallbondtechnologie

Messeforum Halle 7A, Stand 7A-335

Exhibition Forum hall 7A, booth 7A-335

Mittwoch, 27.04.2016 *Wednesday, 27 April 2016*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Thema / Theme: „Optic Meets Electronics“			
10:00 - 10:15	TBA	TBA	TBA
10:15 - 10:30	TBA	TBA	TBA
10:30 - 10:45	TBA	TBA	TBA
10:45 - 11:00	TBA	TBA	TBA
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
11:00 - 12:00	Productronic, Hüthig Verlag	Marisa Robles Consée	Sind wir schon am Ende des SMT-Universums angelangt? Namhafte Hersteller von Bestückplattformen und weitere Anbieter entlang der SMT-Fertigung geben Auskunft über die aktuellen Bewegungen am SMT-Firmament.
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
12:00 - 12:20	Mentor Graphics (Deutschland) GmbH	Michael Ford	TBA
12:20 - 12:40	FELDER GmbH Löttechnik	Udo Grimmer-Herklotz	Die neue FELDER-SMD-Lötpaste ISO-Cream "Clear"
12:40 - 13:00	ZESTRON Europe	Tanja Breu	Qualitätssteigerung durch 4.0 Integration moderner Reinigungsprozesse
13:00 - 13:20	TOWA Europe B.V. PDC	Huub Claassen	Transfer and Compression Molding solutions for any packaging requirement
13:20 - 13:40	Wickon Hightech s.r.o.	Roman Wieser	3D Wire Bonding/Paste Printing - Inspektion
13:40 - 14:00	ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH	Claus Zabel	Vapor-Phase Inline Vakuumlöten Fertigungskonzepte zur Ermöglichung höchster Durchsätze
14:00 - 14:20	John P. Kummer GmbH	Christoph Knes	Reproduzierbar dosieren ab 0,06µl
14:20 - 14:40	Straub-Verpackungen GmbH	Patrick Gemeinder, Ulf Rahe	Nie wieder Spannung - ESD-Verpackungen aus Wellpappe
14:40 - 15:00	Finetech GmbH & Co. KG	(B.-Eng.) Dan Lilie	Advanced Rework Applications in a Shrinking World

smthybridpackaging

Messeforum Halle 7A, Stand 7A-335

Exhibition Forum hall 7A, booth 7A-335

Mittwoch, 27.04.2016 *Wednesday, 27 April 2016*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
15:00 - 16:00	Fraunhofer IZM	Dipl.-Ing. Karl-Friedrich Becker	Moldverkapselung als Baustein für die Systemintegration Technologieübersicht Transfer/Compression-Molden Materialien und Zuverlässigkeitspotential Maschinenteknik und Fertigungs-Beispiele
16:00 - 16:40	Rochester Institute of Technology	Prof. Dr. Martin K. Anselm	What is The Surface Mount Technology Association (SMTA) And Can a Chapter be Founded in Germany?

Donnerstag, 28.04.2016 *Thursday, 28 April 2016*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
09:40 - 10:00	Straub-Verpackungen GmbH	Patrick Gemeinder, Ulf Rahe	Nie wieder Spannung - ESD-Verpackungen aus Wellpappe
10:00 - 10:20	GÖPEL electronic GmbH	Andreas Türk	Inline 3D-Röntgeninspektion in der Automotive Industrie - Hintergrundwissen und Praxisbeispiele
10:20 - 10:40	GPS Technologies GmbH	Andreas Gerspach	High Mix / Low Volume - Fertigung als Eckpfeiler der Wachstumsstrategie
10:40 - 11:00	alpha metals lösysteme GmbH	Jan-Henryk Serzisko	Die Auswahl des richtigen Lotmaterials erhöht die Zuverlässigkeit in der Elektronikfertigung.
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
11:00 - 12:00	Fraunhofer IZM	Ulf Oestermann	Leben und Arbeiten in der digitalisierten Gesellschaft
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
12:00 - 12:20	SmartRep GmbH	Markus Neuer	IPC konforme 3D Messung von Bauelementen und Lötstellen
12:20 - 12:40	Weller Tools GmbH	Robert Göttler	Saubere Luft am Arbeitsplatz
12:40 - 13:20	SET Corporation SA	Caroline Avrillier	SET and its equipment: - Introduction of SET - Introduction of our current flip-chip bonders line - Introduction of the two brand new equipment we are going to introduce at the occasion of SMT
13:20 - 13:40	iTAC Software AG	Andreas Rudl	Wie optimiert MES & Industrie 4.0 die Elektronikfertigung?
13:40 - 14:00	Koh Young Europe GmbH	Axel Lindloff	ClosedLoop und Feedback

smthybridpackaging

EMS / PCB Forum Halle 6, Stand 6-230

EMS / PCB Forum hall 6, booth 6-230

Dienstag, 26.04.2016 *Tuesday, 26 April 2016*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
11:00 - 11:20	Vermes Microdispensing GmbH	Jürgen Städtler	Jet-Mikrodosierung – Innovationen und Zukunftstrends
11:20 - 11:40	Essemtec AG	Roger Rutz	Neue hochflexible Maschinengeneration: Bestücken und Dispensen auf einer Maschine
11:40 - 12:00	HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH	Holger Krumme	Dienstleistungsspektrum der HTV-Firmengruppe
12:00 - 13:00	EIPC European Institute of Printed Circuits	Alun Morgan	TBA
13:00 - 13:20	Beta LAYOUT GmbH	Gernot Seeger	Identification and Traceability matters in electronics - PCBs with embedded RFID technology
Fördermittel-Tage			
15:00 - 16:00	TBA	TBA	TBA
Preisverleihung			
16:00 - 16:15	Mesago Messe Frankfurt GmbH	TBA	SMT Hybrid Packagung Besucher-Gewinnspiel: Verlosung

smthybridpackaging

EMS / PCB Forum Halle 6, Stand 6-230

EMS / PCB Forum hall 6, booth 6-230

Mittwoch, 27.04.2016 *Wednesday, 27 April 2016*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussionen ZVEI / Panel Discussions ZVEI			
10:00 - 11:30	cms electronics Zollner Elektronik Profectus ccs Eltroplan	Moderation: Michael Velmeden Markus Biener Helmut Bechtold Dr. Peter Schmitt Gustl Keller	Services in EMS Initiative: Produktentwicklung ist Teamwork
11:30 - 12:30	Bosch Vacuumschmelze	Dr. Marc Nikolussi Harald Hundt	Bauteilsauberkeit
12:30 - 13:30	Zollner Elektronik Ilfa Feinstleiteteknik Laserjob	Markus Biener Arnold Wiemers Carmina Läntsch	DesignChain in der Elektronikfertigung
13:30 - 15:00	Airbus Defence and Space - EADS Deutschland Airbus Defence and Space - EADS Deutschland Martin GmbH Zollner Elektronik Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie Airbus Defence and Space - EADS Deutschland	Thomas Lauer Thomas Lauer Franz Leitenstern Michael Zimmerer Helge Schimanski Dr. Helmut Schweigart	Leitfaden Repair und Rework von elektronischen Baugruppen Allgemeine Aspekte Reworksysteme Rahmenbedingungen Analytik/Schliffe Empfehlungen/Neuralgische Punkte
Podiumsdiskussionen / Panel Discussions			
15:00 - 16:00	RoodMicrotec GmbH	Gerhard Bayer	Ausfallbilder an elektronischen Baugruppen
Preisverleihung			
16:00 - 16:15	Mesago Messe Frankfurt GmbH	TBA	SMT Hybrid Packagung Besucher-Gewinnspiel: Verlosung